

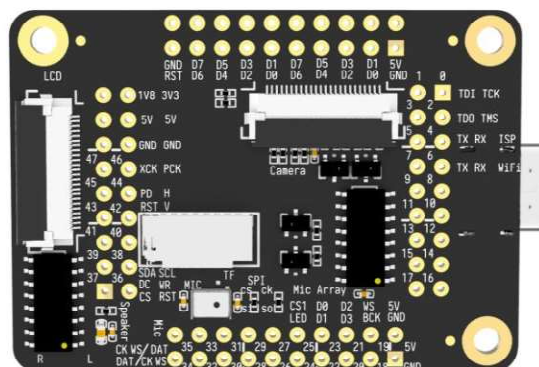
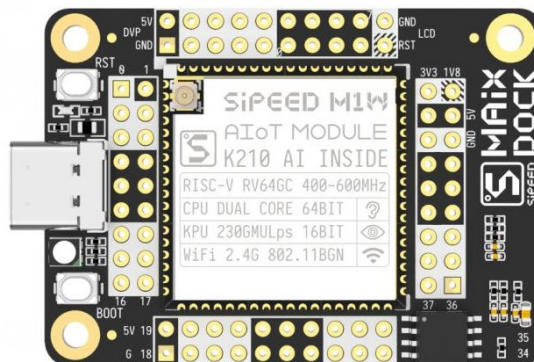
Sipeed

Maix-Dock

规格书 v1.0

特性:

- CPU : RISC-V 64bit 双核处理器, 400Mhz 标准频率(可超频)
- 图像识别:
QVGA@60FPS/VGA@30FPS
- MEMS 麦克风 :
MSM261S4030H0
灵敏度 : -26(dB,dBFS @1kHz
1Pa)
- 音频:
DAC+PA(支持 2x3W 扬声器)
- Micro SD 卡插槽(TF card)
- 下载电路:
只需要连接 USB typeC 线即可完成
下载
- 24P DVP 和 24P MCU LCD 连接器
- 无线功能(可选):
支持 2.4G 802.11.b/g/n



Version 1.0

Sipeed

Copyright © 2019

www.sipeed.com

本文档更新记录

V1.0	编辑时间：2019 年 7 月 9 日；原始文档

功能概述

主要模块	Sipeed M1 或者 M1W AIOT 模块(关于更多详细信息，请阅读以下规格书：Sipeed M1 规格书 V1.1.pdf 和 Sipeed M1W 规格书 V1.0)
GPIO 接口	所有 GPIO 已连接到 2.54mm 间距的直插焊盘
Micro SD card (TF card) 插槽	小尺寸 TF 卡插槽
板载 MEMS 麦克风	MSM261S4030H0 是一个全方位、底部端口、I2S 数字输出的 MEMS 麦克风。它具有高性能和可靠性。
DVP 摄像头接口	24P 0.5mm FPC 连接器
LCD 接口	24P 0.5mm FPC 连接器(8 bit MCU LCD)
音频	TM8211 DAC + PAM8403 PA(支持 2x3W 扬声器)
按键	Boot 按键和 Reset 按键

软件概述

FreeRtos & Standard SDK	支持 FreeRtos and Standrad development kit.
MicroPython Support	支持 MicroPython on M1
机器视觉	基于卷积神经网络的机器视觉
机器听觉	高性能麦克风阵列处理器

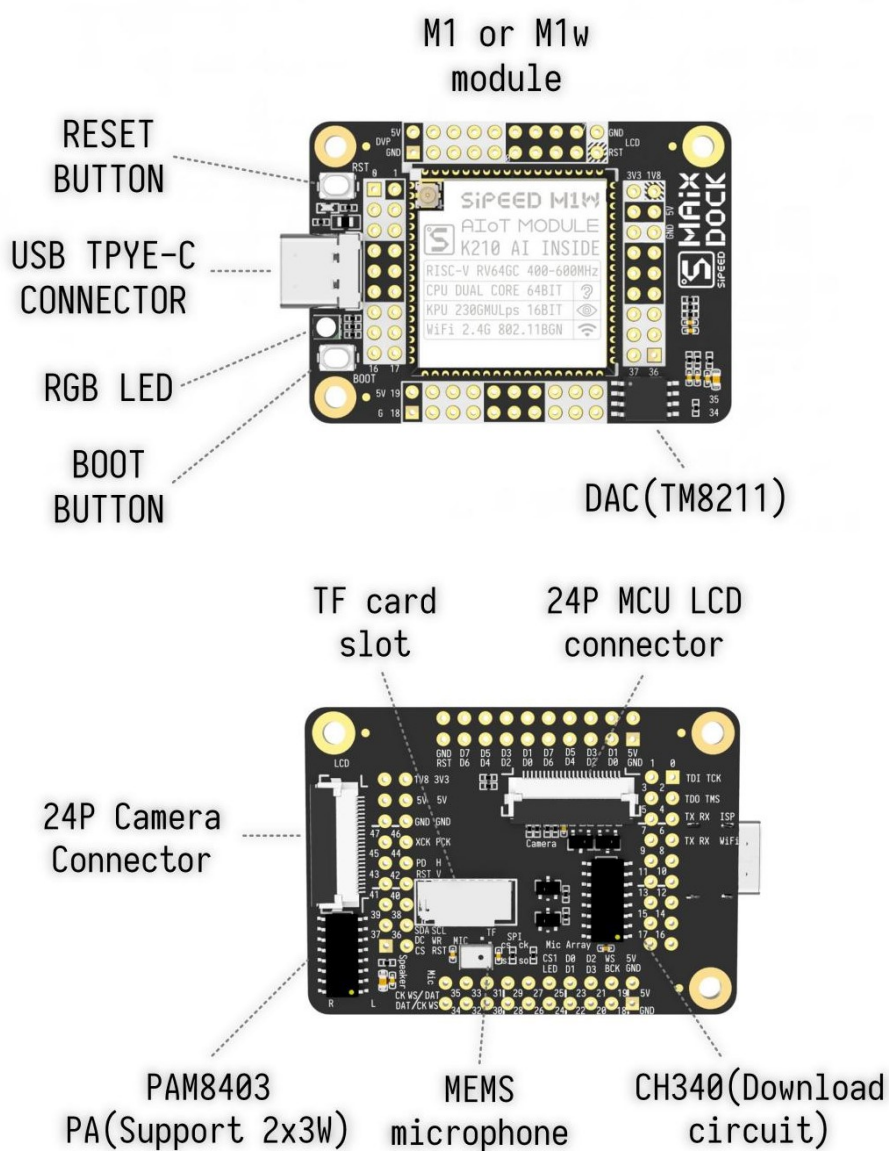
硬件概述

外部供电电压需求	4.8V ~ 5.2V
外部供电电流需求	>600mA
温升	<30K
工作温度范围	-30°C ~ 85°C

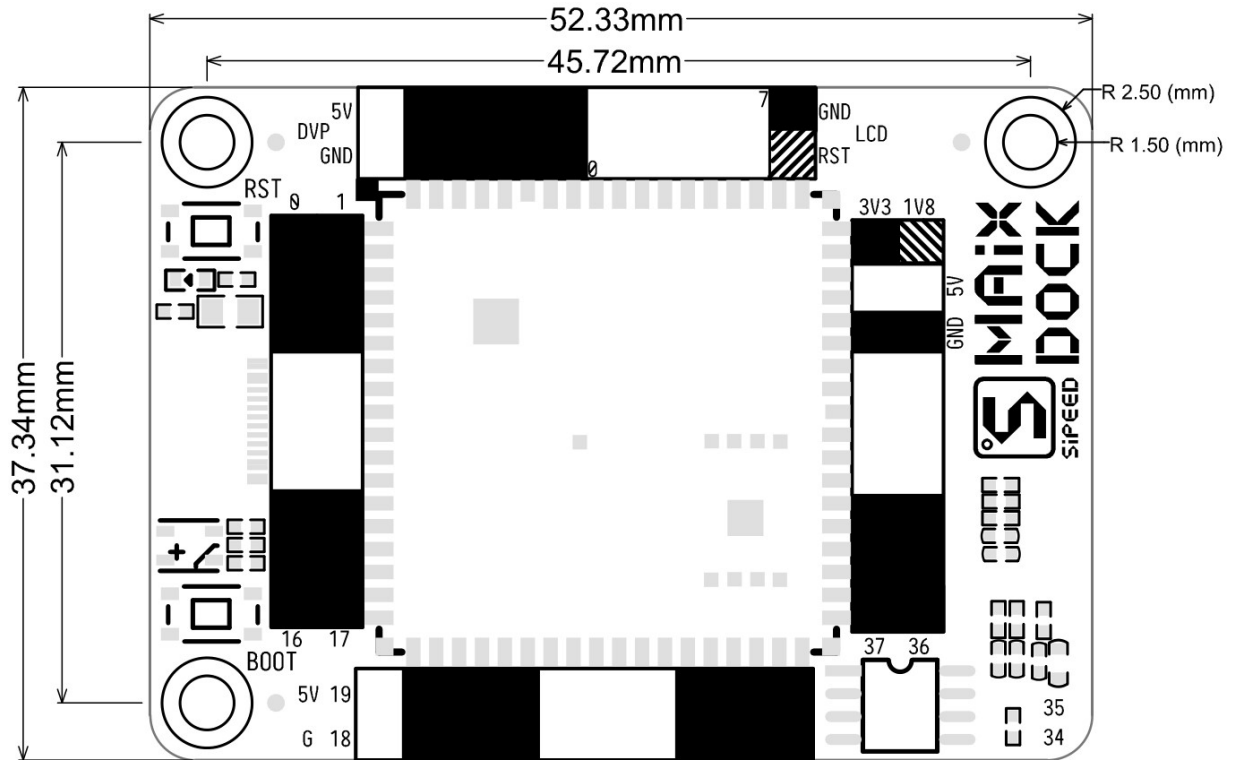
射频特性 (仅 M1w-Dock 拥有)

MCU : ESP8285	Tensilica L106 32-bit MCU
无线标准	802.11 b/g/n
频率范围	2400Mhz - 2483.5Mhz
发射功率 (传导测试)	802.11.b : +15dBm 802.11.g : +10dBm(54Mbps) 802.11.n : +10dBm (65Mbps)
天线连接器	IPEX 3.0x3.0mm
Wi-Fi 模式	Station/SoftAP/SoftAP+Station

总体描述



尺寸信息



资源	
官网	www.sipeed.com
Github	https://github.com/Lichee-Pi
BBS	http://bbs.sipeed.com
Wiki	maixpy.sipeed.com
SDK Relevant information	dl.sipeed.com/MAIX/SDK
HDK Relevant information	dl.sipeed.com/MAIX/HDK
E-mail(技术支持和商业合作)	support@sipeed.com
telgram link	https://t.me/sipeed



免责声明和版权声明

本文档中的信息（包括 URL 地址）如有更改，恕不另行通知。

该文档由 Sipeed™提供，不附带任何形式的担保，包括任何适销性担保，以及其他地方提及的任何提案，规范或样本。本文档不构成责任，包括使用本文档中的信息侵犯任何专利权。

Copyrights © 2018 Sipeed Limited. All rights reserved.